

6-147424-3 ✓ 有效

AMPMODU | Modu Connector System

TE 内部编号 6-147424-3

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 26 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal, Modu Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 26

行数: 2

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 施加的压力       | 标准       |
| 连接器系统       | 板对板      |
| 可密封         | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装母端 |

### 结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 板对板配置    | 平行 |
| 可堆叠      | 是  |
| 位数       | 26 |
| 行数       | 2  |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

### 电气特征

|            |          |
|------------|----------|
| 绝缘电阻       | 5000 MΩ  |
| 介质耐压 (最大值) | 750 Vrms |
| 工作电压       | 333 VAC  |

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 连接器外形  | 标准 |
| 主要产品颜色 | 黑色 |

### 接触件特性

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 端子保护类型         | 闭合入口壳体          |
| 接合方柱尺寸         | .64 mm[.025 in] |
|                | 150 – 300 μin   |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | .762 μm[10 μin] |
| 端子形状和构造        | 短点              |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡               |
| 端子基材           | 磷青铜             |
| 端子接触部电镀材料      | 金               |
| 端子类型           | 插座              |
| 端子额定电流（最大值）    | 2 A             |

### 端接特性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 矩形端接柱体和尾部厚度 | .2 mm[.008 in]   |
| 矩形端接柱体和尾部宽度 | .69 mm[.027 in]  |
| 端接柱体和尾部长度的  | 2.92 mm[.115 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接          |

### 机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 连接器安装类型  | 板安装 |
| 接合对准     | 不带  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| PCB 安装固定 | 不带  |

### 壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 接合入口位置  | 顶部             |
| 外壳材料    | 聚酯 - GF        |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

### 尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 堆叠高度       | 9.02 mm[.355 in] |
| 连接器高度      | 8.64 mm[.34 in]  |
| PCB 厚度（建议） | 1.57 mm[.062 in] |
| 行间距        | 2.54 mm[.1 in]   |

### 使用环境

|         |    |
|---------|----|
| 壳体温度额定值 | 标准 |
|---------|----|

工作温度范围 -65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

### 操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 焊接工艺特性 | 板支座    |
| 电路应用   | Signal |

### 行业标准

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0              |

### 包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装数量 | 17        |
| 封装方法 | Box, Tube |

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|   |   |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量  | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。  |
| 焊接工艺能力  | 波峰焊接可达到 240°C   |

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Modu Connector System



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[26 MODII VRT DR CE .100 X .100](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-147424-3\\_F.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-147424-3\\_F.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-147424-3\\_F.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[AMPMODU\\_INTERCONNECTION\\_SYSTEM\\_SECTION5](#)

英文版本

### 产品规格

#### 应用规格

英文版本